



最新世代 PowerEdge

ワークロード別ポートフォリオ

PowerEdgeサーバー最新世代ポートフォリオ概要

進化するお客様のニーズに応じたサーバーの専用設計

AI / ML



AI 学習



データ
分析

Edge / Telco



テレコム



リテール



製造

CSP



クラウドサービス
プロバイダー

Core



プライベートDC

Datacenter
コロケーション
コンピュータ



トラディショナル
DC



Military



銀行



リテール

PowerEdgeサーバー最新世代ポートフォリオ

進化するお客様のニーズに応じた用途別サーバー

コア

アクセラレーター活用



XE9680



XE9640



XE8640



R760xa

メインストリーム

4ソケット



R760



R660



R7625



R6625



R960



R860



T560

ストレージ密度



R760xd2

メインストリームコスト効率



R7615



R6615



R760xs



R660xs

モジュール



MX760



C6620

エッジ



XR8000



XR5610



XR7620



XR4000

スケールアウト

クラウドサービスプロバイダー向け



HS5620



HS5610

メインストリーム ラック型サーバー

Reimagine IT Possibilities...

R660/R760ポートフォリオ



ワークロード

データセンターの標準化

データベース分析

高密度仮想化

仮想デスクトップインフラ

オンライントランザクション処理

インメモリデータベース



R660 : 1U/2S

より高いラック密度の2ソケットサーバー



R760: 2U/2S

構成の柔軟性を最大化

最も負荷の高いアプリケーションに求められる
パフォーマンスと汎用性を提供

- ✓ **最高のパフォーマンス**
AI/MLなどの負荷の高いワークロード向けの高性能プロセッサ、GPU、次世代ストレージにより、収集したデータからより速く価値を抽出
- ✓ **ピーク性能も空冷で対応**
空冷式シャーシの高性能CPUによる構成を活用
- ✓ **アジリティの提供**
vSAN (HCI) 環境で最大限のスケラビリティで導入可能、ベアメタル環境では新たなPERC12で最高のアプリケーションパフォーマンスで導入可能

PowerEdge R760

最大28ドライブサポート

- 24 NVMe ダイレクトアタッチドライブ
- Gen5 NVMe* & SAS4 サポート
- リア: ブート用ホットプラグ BOSS-N1 (2 x M.2 NVMe)
- 次世代HW NVMe RAID

高速かつメモリ容量サポート

- 最大32 DDR5 DIMMs
- 最大4800 MT/s (1DPC) または 4400 MT/s (2DPC)



2 ソケット対応

- 最大2つの第4世代 Intel® Xeon® Scalable プロセッサ (1CPUあたり最大56コア)
- 高帯域幅メモリ CPU

GPUサポート

- 2 x 300W (DW) または 6 x 75W (SW)

フレキシブル I/O

- 最大8 x PCIe Slots
- Optional 2 x 1GbE LOM + 1 x OCP 3.0 slot

- Smart Cooling
- ダイレクトリキッドクーリング(DLC) サポート
- 成長するスケールアウトソリューション向けの設計と空冷サポート
- 業界をリードする管理性とセキュリティ

TARGET WORKLOADS



ハイパフォーマンススケールアウトデータベース

最新のDDR5メモリテクノロジー、高帯域幅ネットワーク、Gen5ベースのNVMeストレージを備えた高コアCPUを使用して、成長とスケラビリティを実現



ネクストレベルの仮想化

8TBのメモリと最新世代のIntel CPUの112コアを組み合わせることで、2Sサーバーでの高密度仮想化が可能



AIトレーニングの加速

最大のデータセットにおける最高のスループットを提供するよう設計された最新のGen5 PCIe対応のNVIDIA GPUおよびNVMeドライブはトレーニングサイクルの短縮やAI展開の迅速化からお客様利益を可能にする

PowerEdge R660

最大16 ドライブサポート

- SAS4/SATA/ NVMe Gen4とGen5のストレージオプション
- リアポート用ホットプラグ BOSS-N1 (2 x M.2 NVMe)
- 次世代HW NVMe RAID

高速かつメモリ容量サポート

- 最大32 DDR5 DIMMs
- 最大4800 MT/s (1DPC) または 4400 MT/s (2DPC)



2 ソケット対応

- 最大2つの第4世代 Intel® Xeon® Scalable プロセッサ (1CPUあたり最大56コア)
- 高帯域幅メモリ CPU

GPUサポート

- 3 x SW GPUs

フレキシブル I/O

- 最大3 x PCIe Slots
- Optional 2 x 1GbE LOM + 1 x OCP 3.0 slot

- Smart Cooling
- ダイレクトリキッドクーリング(DLC) サポート
- 成長するスケールアウトソリューション向けの設計と空冷サポート
- 業界をリードする管理性とセキュリティ

TARGET WORKLOADS



ハイパフォーマンスシミュレーション & モデリング

通常のDDR5 DIMMの4倍のメモリ帯域幅と組み合わせたCPUコア数の多い高帯域幅メモリCPUを備えた空冷式1U HPCクラスターで比類のないパフォーマンスを提供



オンライントランザクションプロセス

Gen5 PCIe NVMeドライブと大容量メモリで構築された次世代の高性能インテルCPUにより、より高速で安全なオンライントランザクションを実現



オールフラッシュ vSAN

NVMe 直接接続ストレージ構成に高周波CPUを搭載したvSAN ノードを導入することで、HCIの実装を進め、より高いスループットを実現

MAINSTREAM

Reimagine IT Possibilities...

AMD 2ソケット ポートフォリオ



ワークロード

ハイ・パフォーマンス・コンピューティング (HPC)

仮想化

仮想デスクトップインフラストラクチャ (VDI)

データ分析



R6625 : 1U/2S

集約率を最大化する1U2ソケット



R7625 : 2U/2S

PCIeとストレージの最大化

パワフルで高密度、空冷・水冷に対応した
データセンターのバックボーンを担うサーバー



究極のパフォーマンス

第4世代AMD EPYC、
DDR 5メモリ、PCIe Gen5。
上位CPUまで空冷対応
でスペースあたり性能も
最大化。



仮想マシン搭載数を 最大化

CPUコア数は50%向上。
VDI向けに最大6 GPU
構成も可能



強化された拡張性

E3.Sドライブにより
サーバーあたり
33%多くのデータを格納。
貴重なデータセンターの
フロアスペースを節約

PowerEdge R7625

A step ahead in processing

- 最大2つの第4世代AMD EPYC™ プロセッサで稼働 (1 CPUあたり最大96コア)
- 最大24 x DDR5 RDIMMs (6TB max)

I/O とコネクティビティ

- 最大8 x PCIe slots (最大4 x Gen5)
- ネットワークカード用 OCP 3.0



フレキシブルストレージ

- 最大12 x 3.5" – 12Gb SAS, 6Gb SATA
- 最大24 x 2.5" – 12Gb SAS, 6Gb SATA, NVMe
- 最大32 x E3.S – NVMe
- リア: 最大4 x 2.5" ホットプラグSAS/SATA または NVMe HDDs, 最大4 x E3.S NVMe

- Smart Cooling
- ダイレクトリキッドクーリング(DLC) サポート
- 業界をリードする管理性とセキュリティ

TARGET WORKLOADS



データ分析

ストレージの最大化メモリー構成オプションはHPCやML/DL/AIやレンダリングを可能にする



オールフラッシュSDS

24 x 2.5" U.2 Gen4 NVMe または 32 x E3.S ドライブはオールフラッシュストレージをサポート



VDI

コア数とGPUのバランスを取り、最大数のエンドユーザーをサポート

MAINSTREAM

PowerEdge R6625

2 ソケット対応

- 最大2つの第4世代AMD EPYC™ プロセッサで稼働 (1 CPUあたり最大96コア)
- 最大24 x DDR5 RDIMMs (6TB max)

I/O とコネクティビティ

- 最大3 x PCIe slots (最大2 x Gen5)
- ネットワークカード用 OCP 3.0



フレキシブルストレージ

- 最大4 x 3.5" SAS/SATA or SSD
- 最大10 x 2.5" SAS/SATA, SSD または NVMe
- 最大14 x E3.S ホットプラグ NVMe
- HW NVMe RAID

- Smart Cooling
- ダイレクトリキッドクーリング(DLC) サポート
- 業界をリードする管理性とセキュリティ

TARGET WORKLOADS



HPC

HPCは最高のメモリパフォーマンスとスケールアウトクラスターのために1DPC設計が必要



Dense VDI

エンドユーザーのVDIパフォーマンスを高速化するマルチGPUサポート



仮想化

24.08 @ 28 タイルのVMMark w / vSAN 世界記録のパフォーマンスは、以前の記録より81.5% 向上

MAINSTREAM

イノベーションを加速

PowerEdge R860 & R960



ワークロード

大規模インメモリ データベース
SAP HANA

仮想化、高密度VDIシステム、
VM/コンテナオペレーション

金融やヘルスケア業界を含むミッション
クリティカル/ビジネスクリティカルな
ITオペレーション



R860

2U筐体に4 CPU + 64DIMM搭載



R960

4CPU + 64DIMM搭載で
さらにストレージとI/Oも最大化

ビジネスを加速するデータドリブンでビジネスクリティカルな能力を
コアDC、ハイブリッドクラウド、スケーラブル環境まで幅広く提供

- ✓ **成果をアクセラレート**
大規模インメモリDBワーク
ロードにパワフルな処理
能力を発揮、ビジネス
インサイト取得までの
時間を最短化
- ✓ **高密度仮想化システムに
最適化**
最大240個のCPUコアで
VM/VDIパフォーマンスを
最大化し、リソース利用率
のシンプル化とTCO削減を
実現
- ✓ **スケーラブルな柔軟性**
異なる複数のワークロード
ニーズに応じてスケールア
ップ：DDR5メモリ最大16TB、
最大32本の高速ドライブと
12本のPCIe Gen5スロットに
よるI/Oのヘッドルーム

PowerEdge R860

エクストリームコンピューティングパワー

- 最大4つの第4世代 Intel® Xeon® Scalable プロセッサ (1CPUあたり最大60コア)

Support for highest memory speed & capacity

- 最大64 DDR5 RDIMMs
- 最大4800 MT/s (1DPC) もしくは4400 MT/s (2DPC)



最大24ドライブサポート

- 最大24 NVMe ダイレクトアタッチドライブ
- Gen5 NVMe & SAS4 サポート
- リア: ブート用ホットプラグBOSS-N1 (2 x M.2 NVMe)
- 次世代HW NVMe RAID

Flexible I/O

- 最大8 x PCIe Gen 5 Slots
- 1 x OCP 3.0 slot
- 専用の内蔵PERC

- 持続可能なエネルギー目標を達成するための5つのPSU(ゴールドまたはプラチナ)の選択
- さまざまな構成において空冷を最適化、オプションのDellダイレクトリキッドクーリングサポート
- 業界をリードする管理性とセキュリティ

TARGET WORKLOADS



大規模なインメモリーデータベース

最大64個のDIMMにより、インメモリーデータベースのサポートを最大化



仮想化/VDI

4つのCPUとメモリ、ストレージ、I/Oの最大容量を備えたこのプラットフォームは、最も高密度の仮想化スタックに最適



LOB アプリケーション

最も要求の厳しい基幹業務アプリケーションをサポートする柔軟性と容量

MAINSTREAM

PowerEdge R960

エクストリームコンピューティングパワー

- 最大4つの第4世代 Intel® Xeon® Scalable プロセッサ (1CPUあたり最大60コア)

最高のメモリ速度と容量のサポート

- 最大64 DDR5 RDIMMs
- 最大4800 MT/s (1DPC) もしくは4400 MT/s (2DPC)



最大36 ドライブサポート

- 最大36 NVMe direct attached drives
- Gen5 NVMe & SAS4 Support
- リア: ブート用ホットプラグ BOSS-N1 (2 x M.2 NVMe)
- 次世代HW NVMe RAID

フレキシブル I/O

- 最大12 x PCIe Gen 5 Slots
- 1 x OCP 3.0 slot
- 専用の内蔵PERC

- 持続可能なエネルギー目標を達成するための5つのPSU(ゴールドまたはプラチナ)の選択
- さまざまな構成において空冷を最適化、オプションのDellダイレクトリキッドクーリングサポート
- 最大4つのダブルワイドGPUをサポート
- 業界をリードする管理性とセキュリティ

TARGET WORKLOADS



Large In-Memory Databases

最大64個のDIMMにより、インメモリデータベースのサポートを最大化



仮想化/VDI

4つのCPUとメモリ、ストレージ、I/Oの最大容量を備えたこのプラットフォームは、最も高密度の仮想化スタックに最適



LOB Applications

最も要求の厳しい基幹業務アプリケーションをサポートする柔軟性と容量

MAINSTREAM

タワー型

PowerEdge T560

卓越したパフォーマンス

- 最大2つの第4世代 Intel® Xeon® Scalable プロセッサ (1CPUあたり最大32コア)
- 最大16 x DDR5 RDIMMs (1TB max)
- 最大4800 MT/s (1DPC) もしくは4400 MT/s (2DPC)

高い信頼性を実現する設計

- ホットプラグ BOSS
- ホットプラグ HDD/SSD
- ホットプラグ冗長電源
- PERC 11 & 12, SW と HW RAID, フロント, 内蔵PERC とアドインカードオプション

拡張可能なI/Oおよびストレージ

- より速いI/O スループット: PCIe Gen 5
- メモリーパフォーマンス増加: DDR5 4800MT/s
- 最大ストレージの増加: 最大12 x 3.5" HDDまたは24 x 2.5" SSDsまたは8 x 3.5"/2.5" HDD+ 8 x NVMe SSD

データ分析と機械学習の準備

- 最大2 Double-Wide GPU
- 最大4 x PCIe Gen 4 slots

業界をリードする管理性とセキュリティ

TARGET WORKLOADS



データベース

オンサイトまたはリモートで情報とプロセスを共有する人々のグループ間のコラボレーションアプリケーションを可能にする組み込み機能



Medium Duty 推論

中規模の AI または ML に合わせた推論アルゴリズムを強化して、よりタイムリーで正確なビジネス分析情報を促進するように調整



仮想化

ソフトウェア仮想化の利点を模索している中規模企業に最適

ROBO / SMB

メインストリーム Optimized

Reimagine IT Possibilities...

「XS」シリーズポートフォリオ



XSワークロード

汎用ワークロード

汎用VDI

クラウド

HPC



R660xs: 1U/2S

より高密度



R760xs: 2U/2S

柔軟なストレージとアクセラレーション

最も一般的なITアプリケーション用に、
空冷コンピューティングで適切なバランスを求めるお客様に最適



考え抜かれた設計

現在のインフラにマッチし、
要求の厳しいエンタープライズアプリケーションをサポートするための適切なパフォーマンス機能を提供



容易な構成

ニーズに合わせて交換可能な各種コンポーネントが付属



空気で冷却

特許取得済みのマルチベクター空冷システムを搭載

PowerEdge R760xs

2 ソケット対応

- 最大2つの第4世代 Intel® Xeon® Scalable プロセッサ (1CPUあたり最大32コア)
- 最大250W

メモリーサポート

- 最大16 DDR5 DIMMs (1TB max)
- 最大4800 MT/s



フレキシブルストレージ

- 最大16 x 2.5" + 8x NVMe もしくは16 x 2.5" または12 x 3.5" ストレージオプション
- 次世代HW NVMe RAID (PERC12)
- ブート用ホットプラグBOSS-N1 (2 x M.2 NVMe)

フレキシブル I/O

- 最大6 x PCIe slots (up to 2 x Gen5)
- 1 x OCP 3.0 slot
- 1 x 専用の内蔵 PERC
- 最大2 x SW GPU (NVIDIA A2)

- Smart Cooling
- 成長するスケールアウトソリューション向けの設計と空冷サポート
- 業界をリードする管理性とセキュリティ

TARGET WORKLOADS



仮想化

ソフトウェア仮想化のメリットを模索している中規模企業に最適な選択肢



中密度VM / VDI

最大1TBのメモリと豊富なコアを備えたR760xsは、マイナーアクセラレータのサポートが可能な一般的な仮想マシンまたはVDIインスタンスに最適なサイズ



Software-Defined Storage Node

SDSの構築のため、最大24 ドライブ (最大16x NVMe)

MAINSTREAM OPTIMIZED

PowerEdge R660xs

2 ソケット対応

- 最大2つの第4世代 Intel® Xeon® Scalable プロセッサ (1CPUあたり最大32コア)
- 最大250W

メモリーサポート

- 最大16 DDR5 DIMMs (1TB max)
- 最大4800 MT/s



フレキシブルストレージ

- 最大10 x SAS/SATA/NVME ドライブ
もしくは最大4 x 3.5" 大容量 SATA HDDs
- 次世代HW NVMe RAID (PERC12)
- USBとブート用内蔵BOSS-N1 (2 x M.2 NVMe)

フレキシブル I/O

- 最大3 x PCIe slots
- 1 x OCP 3.0 slot
- 1 x 専用の内蔵PERC

- Smart Cooling
- 成長するスケールアウトソリューション向けの設計と空冷サポート
- 業界をリードする管理性とセキュリティ

TARGET WORKLOADS



仮想化 / クラウド

中密度の仮想化とクラウドネイティブには、低中規模のローカルストレージが必要



スケールアウトデータベース

中負荷の従来のデータベースと小中規模のローカルストレージを備えたスケールアウトデータベース



ハイパフォーマンスコンピューティング

最高のメモリパフォーマンスとスケールアウトクラスターの為、HPCには1DPC設計が必要

MAINSTREAM OPTIMIZED

Reimagine IT Possibilities...

AMD 1ソケットサーバー ポートフォリオ



ワークロード

データ分析

ソフトウェア定義ストレージ

高密度仮想化システム

メモリ転送速度の向上と柔軟なストレージオファリング、
価格あたりパフォーマンスを飛躍的に向上しROIを最大化。



R6615 : 1U/1S

1ソケット最大のコンピュート密度



R7615 : 2U/1S

PCIeとストレージを最大化



究極のパフォーマンス

第4世代AMD EPYC、
DDR 5メモリ、PCIe Gen5。
上位CPUまで空冷対応
でスペースあたり性能も
最大化。



仮想マシン搭載数を 最大化

CPUコア数は50%向上。
VDI向けに最大6 GPU
構成も可能



強化された拡張性

E3.Sドライブにより
サーバーあたり
33%多くのデータを格納。
貴重なデータセンターの
フロアスペースを節約

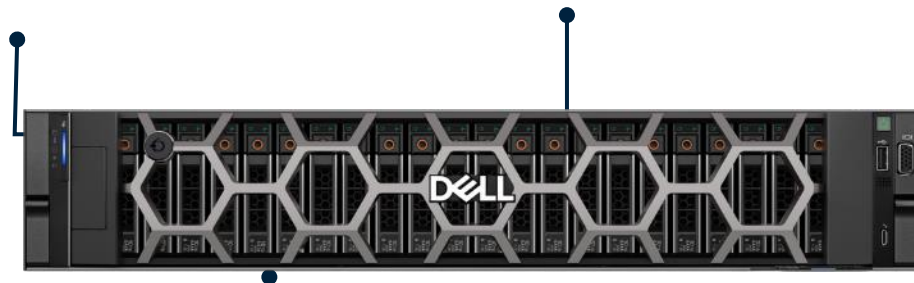
PowerEdge R7615

必要なソケット

- 1つの第4世代AMD EPYC™ プロセッサで稼働 (最大96コア)
- 最大12 x DDR5 RDIMMs (3TB max)

I/O とコネクティビティ

- 最大8 x PCIe slots (最大4 x Gen5)
- OCP 3.0 for network cards



フレキシブルストレージ

- 最大12 x 3.5" – 12Gb SAS, 6Gb SATA
- 最大24 x 2.5" – 12Gb SAS, 6Gb SATA, NVMe
- 最大32 x E3.S – NVMe
- リア: 最大4 x 2.5" ホットプラグ SAS/SATA or NVMe HDDs, 最大4 x E3.S NVMe
- ブート用内蔵 BOSS-N1 (2 x M.2 NVMe)

- Smart Cooling
- ダイレクトリキッドクーリング(DLC) サポート
- 業界をリードする管理性とセキュリティ

TARGET WORKLOADS



SDS

SAS/SATA/NVMe 直接接続



仮想化

1Sで最高のVM密度を実現する高いコア数のパフォーマンス



データ分析

マルチダイ構想はビッグデータとコンテンツに低遅延と浮動小数点容量を提供

MAINSTREAM OPTIMIZED

PowerEdge R6615

必要なソケット

- 1つの第4世代AMD EPYC™ プロセッサで稼働 (最大96コア)
- 最大12 x DDR5 RDIMMs (3TB max)

I/O と コネクティビティ

- 最大3 x PCIe slots (最大2 x Gen5)
- OCP 3.0 for network cards



フレキシブルストレージ

- 最大4 x 3.5" SAS/SATA or SSD
- 最大10 x 2.5" SAS/SATA, SSD; or NVMe
- 最大14 x E3.S Hot Plug NVMe
- HW NVMe RAID
- Rear ホットプラグ BOSS-N1

- Smart Cooling
- ダイレクトリキッドクーリング(DLC) サポート
- 業界をリードする管理性とセキュリティ

TARGET WORKLOADS



仮想化

VM密度に伴う費用総額の改善やSQLパフォーマンス向上



HCI

ROBO VxRailにおける低遅延の為に高いパラレルizmと高密度 Azure Stack HCI



NFV

通信事業企業に適用可能な OpenStack Ready アーキテクチャ

MAINSTREAM OPTIMIZED

Edge

エッジ固有のニーズに応えるDellのコンピュータインフラ

機能



高拡張性、アクセラレーター対応、I/O

物理的な特性



筐体の小型化

設置環境



高耐久性

インフラストラクチャ



容易な運用と 堅牢なセキュリティ

お客様の ニーズ

- 高パフォーマンス
- 低消費電力
- Wi-Fi、5G要件への対応
- DPU、EDSFFへの対応

- 浅い奥行、小型シャーシ
- 軽量
- 設置方式の柔軟性
- 容易なサービス・メンテナンス

- 過酷な温度環境
- 防塵性能
- 耐振動
- NEBS、米軍MIL規格

- 仮想化
- オークストレーション
- 遠隔管理
- エッジ環境用サービス

PowerEdge XRシリーズ ポートフォリオ

- 最新のエッジ用インテルCPU
- PowerEdge SDLに基づくセキュリティ設計
- GPUのサポート
- AC/DC電源両方サポート

- 奥行き寸法500mm未満
- 前面I/Oオプションの提供
- 2/4-post rackability

- MIL 810H認証
- NEBS Level 3対応
- 防塵フィルター付き
スマートベゼル
- セキュリティロック付きベゼル

- iDRAC
- Server OS
- VMサポート
- ProDeploy & ProSupport

あらゆる場所で 加速

- 「エッジ向けに設計された」サーバー製品ライン
- 標準ITラック（19インチ）より小さいフィールド キャビネットやラックに収まるショートデプスモデル
- 前面 I/Oによりフィールド エンジニアが狭いスペースでも容易に保守対応
- 過酷で予測不可能なエッジ環境向けの衝撃、振動、粉塵および熱関連の規格 (MIL/NEBS)
- iDRACによるDellの管理エコシステムに対応

Monolithic

XR7620

- 450mm 2U、2S Intel Xeon SP搭載
- EdgeでのAI用に2x 300W GPUをサポート
- GPUとCPUに最適化された構成により、様々なエッジユース・ケースに対応可能
- 5°C～55°Cの動作温度



XR5610

- 400mm 1U、1S インテル Xeon SP
- オンサイト専用ワークロードに最適なサイズ
- 通信事業者に最適化された構成、タイム & シンクカードも利用可能
- 5°C～55°Cの動作温度

Multi-node

XR4000

- Intel Xeon D (Dell 1st) を搭載した 2U マルチノード
- 奥行き350 mm となり、デルの中で最短サーバー
- マイクロ ウィットネス ノードにより、単一のボックスで VM クラスタが可能
- 究極の柔軟性を実現するため、ラック、積み重ね、壁への取り付けが可能
- 5°C ~ 55°C の動作温度



XR8000

- 430mm 2U マルチノード Intel Xeon SP (EEC を含む) を搭載
- DU および CU RAN の展開を目的とした通信事業者向けに最適
- 5°C ~ 55°C の動作温度

Reimagine IT Possibilities...

エッジからコアまでカバーする単一シャーシ



ワークロード

Centralized RAN
Distributed RAN

vRAN/Open RAN
DU/CU deployment

UPF
MEC

PowerEdge XR8000



高耐久のショートデプス シャーシ
(奥行430mm)
前面I/Oアクセス
1Uおよび2Uサーバースレッド

柔軟な構成、多様な環境への対応、RANに最適化。
通信キャリアのエッジ運用向けに専用設計された、
スレッド式のショートデプスサーバー。



柔軟な選択肢

3種類のフォームファクターを
選択可能、1シャーシ
最大4サーバーノード構成。
エッジでの様々なサーバー
導入に広範囲に対応。



熱と低温への耐久性

ヒートシンクの強化と更なる
エアフローの最適化、
大幅な電力効率改善に
より、55C+環境での運
用をサポート。
NEBS/MIL 検証済み。



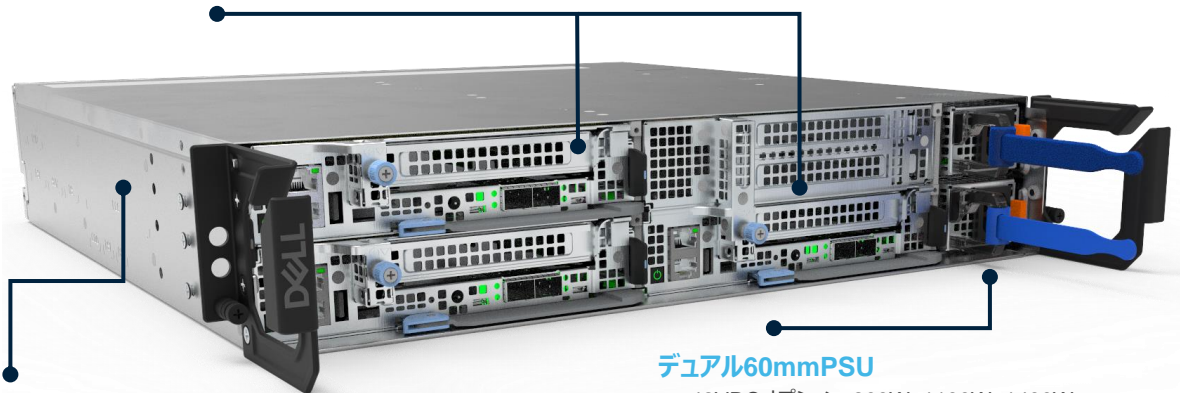
RANに最適化

多様なポート構成と
PTP/SyncEサポート、
柔軟なPCIe構成
のオフリングを提供する
統合済みネットワーク
およびI/O。

Dell PowerEdge XR8000

最大4ノードまで対応可能な幅広い構成が可能、柔軟なI/Oスレドオプション

- エッジ/ファ-エッジおよびGPU最適化ワークロードに対応する2Uハーフ幅スレド構成 x 2
- 高密度コンピ-トおよびネットワークエッジ最適化ワークロードに対応する1Uハーフ幅スレド構成 x 1



ノードあたりシングルソケットのIntel Xeon

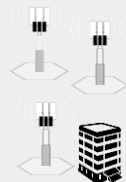
- 最大32コアのXeon スケ-ラブル・プロセッサ
- 最大32コアのXeon Enhanced Edgeプロセッサ

デュアル60mm PSU

- -48VDC オプション: 800W, 1100W, 1400W
- 100 ~ 240VAC オプション: 1400W, 1800W

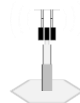
- クラス1 (-5°C ~ 55°C) での動作に最適化
- 前面I/O壁から背面壁まで430mmという奥行きの短さ
- 前面からアクセス可能

TARGET WORKLOADS



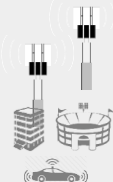
集中型RAN

分散ユニット (DU) と集約ユニット (CU) を統合したハブサイト/LDCの導入に最適化されており、vRAN/Open RANへの移行をサポート



分散型RAN

特定のビル用キャビネットやセルサイトシェルターでのDUおよびDU/CUのセルサイト導入に拡張可能



ネットワークエッジ

ネットワーク最適化、エッジでのクラウドサービス、時間的制約のある業種、モバイルユーザー向けアプリケーションをサポートするMECとUPFのユースケース



軍事・防衛

現場対応可能、現場作業や偵察をリモートでサポート



エンタープライズエッジ

製造業・小売業向けアプリケーション: 映像サービス、インスタントPoS分析、IoTデバイスの集約、AI推論、OT/IT変換



ITの新たな可能性を生む、エッジでのコンピュート

Dell Technologies史上、最も多才なエッジ環境向けサーバーが誕生

最適な
ワークロード

VDI

Machine vision

ビデオ監視システム

vSAN / VM

売り場

データ圧縮システム



PowerEdge XR4000



ラックがある環境向け：2Uラック型シャーシ



ラックのない環境向け：
積み重ねも壁掛けも可能、フレキシブル マウントシャーシ

エッジ環境でのコンピュートインフラ導入に究極の柔軟性をもたらす
Dellのショートデプスサーバー



Nano Server

靴箱程度の筐体サイズでも
HCIを実現。2-Node vSANの
構築に欠かせない
「Witness (監視) ノード」用の
小型スレッド「Nano Server」を
シャーシに物理実装可。



マルチノード デザイン

マルチスレッドデザインにより、
2Uラックシャーシに最大4台
の完全に独立した物理
サーバーノードを稼働。



エッジでのコンピュートに 徹底して最適化

小型ながら高耐久性が売りの
筐体で、-5C~55Cまでの
環境温度で稼働をサポート。
耐久性は米軍MIL規格810H
とNEBS Level 3認証を取得。



PowerEdge XR4000

柔軟な構成オプション

- ストレージ、ネットワーク構築、コンピューティングの最適化
- スレッドベースアーキテクチャにより、必要に応じて拡張可能

2.1ノードvSANをサポート

- ESXiまたはLinuxを実行する組み込み型NPU
- GPU対応構成



シングルソケット

第3世代インテル® Xeon® D

Intel® Xeon® D processor, 最大20C per node

インテリジェントなフィルター付きベゼル

- セキュアなロック付きベゼル
- iDRACによるフィルター監視

柔軟なマウントオプション

- 複数のシステムを安全にスタッキング
- VESAブラケットと互換性あり
- DINレールアダプターオプション

- 1台の2Uシャーシに最大4つの個別サーバーを搭載可能
- -5°C~55°Cの動作温度
- イヤーからラックまでの奥行きが350mmと短い
- 前面および背面のI/Oオプション

TARGET WORKLOADS



小売

POS、未来型店舗、IoT、AI推論などに最適



軍事

携帯性に優れ、一人で持ち運べる軽量タイプ。粉塵環境、高温・低温での運用にも耐えられるよう強化された設計

MIL 810H、461G、901E、1474E規格対応（限定構成）



製造

マシンアグリゲーション、VDI、AI推論、OT/IT変換、産業オートメーション、ROBOなどに最適

EDGE/TELCO

Reimagine IT Possibilities...

エッジでの稼働に最適化された、ショートデプス サーバー



ワークロード

デジタルマニュファクチャリング

マシンアグリゲーション

AI推論

ワークロードの統合

フィールドステーションでの作業

マシンビジョン

XR7620: 2U/2S



前面I/O + 利用可能なスマートベゼルで防塵



既存インフラ用の背面I/Oオプション

エッジ専用設計、コンパクト、かつアクセラレーテッド
エッジでのエンタープライズクラス コンピューティングに対応

- ✓ **エッジに特化した設計**
エッジ環境での使用に耐える設計、MIL/NEBS規格に適合
- ✓ **必要なところでアクセラレーション**
GPUに最大2x300Wのアクセラレーターを追加し、最も要求の厳しいエッジワークロードに対処
- ✓ **データセンターレベルのコンピューティング**
奥行450mmサーバーに2つのIntel Xeon SP CPUを搭載。
-5°Cから55°Cの環境温度をサポート。

Dell PowerEdge XR7620

最大8つのドライブをサポート

- 最大8xのNVMeドライブ
- ブート用BOSS (2 x M.2)
- HW NVMe RAID

最新のメモリ、アクセラレーターをサポート

- 16 DDR5 DIMM @ 4800MTs
- 2x DWアクセラレーター(各最大300W)



2ソケット対応

- 最大2つの第4世代インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサ、最大32コア

柔軟なI/O

- 前面および背面I/O
- 最大4 x PCIe Gen4/5スロット
- ネットワークカード用OCP3.0
- 1x LPスロット

- -5°C~55°Cの動作温度
- 最大2x DWアクセラレーター(300W×2)
- イヤーからラックまでの奥行きが450mmと短い
- 前面および背面のI/Oが利用可能

TARGET WORKLOADS



デジタルマニュファクチャリング

マシンアグリゲーション、VDI、AI推論、OT/IT変換、産業オートメーション、ROBOなどに最適



軍事

粉塵環境、高温・低温での運用にも耐えられるよう強化された設計

MIL 810G規格対応（限定構成）



小売

倉庫業務、POS集約、デジタルサイネージ、在庫管理、ロボティクス、AI推論などに最適

EDGE/TELCO

Reimagine IT Possibilities...

エッジ環境に最適化された、高耐久1Uラック型サーバー



ワークロード

Networking and Communications
5G - vRAN, DRAN, CRAN, ORAN

Military & Defense
Retail

MEC
Remote private network AI/ML/DL

PowerEdge XR5610



- 高耐久のショートデプス1Uラックシャーシ
- リバーシブルI/O
(前面アクセス / 背面アクセス)

エッジ向けに専用設計された、高耐久1Uラック型シャーシ。
通信キャリアのワークロード、防衛や災害救済の現場、そしてビデオ監視、IoTデバイス集約、店舗でのデータ分析などのリテールAIに最適

✓ 多目的1Uシャーシ

多様なワークロードと設置環境に対応し、最新世代のテクノロジーを提供する高性能な1Uサーバー

✓ Edge環境に専用設計

Telco vRANに向けたFECの組み込みなど、通信キャリア、小売り、防衛・災害救済現場などのエッジに専用設計。強化されたCPUを最大32C環境までサポート可能。

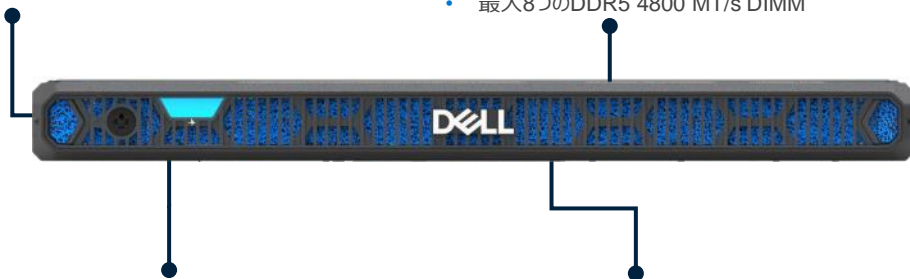
✓ 検証済みの高耐久性

米軍MIL規格の810H、NEBSのLevel 3に準拠し稼働環境の温度は5-55Cまでサポート

Dell PowerEdge XR5610

スケーラブルな内蔵ストレージをサポート

- 最大4x 2.5インチNVMe、SAS、SATA SSD
- OSブート用BOSS-N.1 (2 x M.2)
- HW NVMe RAID



高速化、メモリ容量に対応

- 1x 次世代インテル® Xeon® Sapphire Rapids - SP サーバプロセッサ-最大32コア、およびEE-MCC CPU
- 最大8つのDDR5 4800 MT/s DIMM

1ソケット / 1U Ruggedモノリシックサーバー

- フィルター付きベゼルでクリーンエア運用
- ノーマルおよびリバースエアフローモデル
- 前面または背面IOアクセスモデル

柔軟なIO

- 4x25/10GbE LOM PTPを統合
- OCP 3.0およびまたは2つのPCIe Gen5 x16カードスロットを提供する、最大2つのライザー

- スペースや 環境的な課題のある場所への導入用に設計された、奥行き短い高耐久「Rugged」サーバー。過酷な環境やスペースに制約のある環境下での高温での運用に適しており、テレコム、軍事、防衛産業、商業セクターなどの要求の厳しいワークロードに対応可能。
- 業界最高水準の管理性とセキュリティ

TARGET WORKLOADS



ネットワーク構築と通信

テレコム / 5G: MEC、DU、CU/vRAN、ORAN、CDN。リモートプライベートネットワーク AI/ML/DL



軍事 & 防衛

現場対応可能、現場作業や偵察をリモートでサポート



エンタープライズエッジ

製造業・小売業向けアプリケーション: 映像サーベイランスとPoS分析、IoTデバイスの集約と分析



EDGE / TELCO

Acceleration & Storage Optimized

16G アクセラレーター 搭載専用モデル

- AI/MLソリューションの幅広いポートフォリオの提供で、より速くよりスマートに成果への道を加速
- 空冷式8 GPUならびに液冷式4 GPUのアクセラレータ搭載PowerEdgeで、AIパフォーマンスを最大化
- HPC/AIシステム・パートナーのエコシステムでさらに拡大

XE9680

- 8x SXM GPU、空冷式、6U
- AI ML/DL学習、HPC、インターネットプロバイダーワークロードに向けた、8xSXM GPU市場にDell初の参
- 次世代NVIDIA GPUのTime To Marketを重視



XE9640

- 4 x SXM / OAM GPU、液冷、2Uの高ラック密度
- クラス最高のGPU搭載密度に最適化された液冷式
- 次世代インテルとNVIDIA GPUとのTime To Marketを重視



XE8640

- 4 x SXM GPU、液体アシスト式空冷、4U
- クラス最高峰の最適化がなされた、空冷式GPUを搭載従来型AIワークロードをターゲット
- 次世代NVIDIA GPUのTime To Marketを重視



R760xa

- 最大4xDW / 10xSW PCIe GPU (NVIDIA、インテル、AMD)、2U
- AI ML/DL学習および推論、HPC、レンダーファーム、仮想化ワークロードに最適化されたPCIeアクセラレータサーバー
- 次世代NVIDIA GPUのTime To Marketを重視

インサイト取得までのスピードを加速...

一切の妥協なくAIをアクセラレート



ワークロード

AI : ML/DL学習

ハイパフォーマンスコンピューティング

最適なワークロードと業種 : CRISP、ヘルスケア、CSP、金融、HPC、官公庁、学術系



XE9680: 6U/2S

最新のアクセラレーション技術のパフォーマンスをを
空冷環境で最大化するために専用設計。
お客様の膨大なデータセットからの迅速なインサイト取得をご支援。



AIの成果の取得を加速

8基のNVIDIA H100と
最高350WのCPUによる
パワフルなAI学習パフォーマンスが、ビジネスの意思決定
スピードを加速。



空冷設計

次世代PowerEdge中、
最も高い消費電力を
空冷でサポートする
6Uラックシャーシ。



卓越した柔軟性

NVIDIA H100またはA100、
最大16ドライブと10基の
PCIe Gen5スロットによる
スケールアップ性能

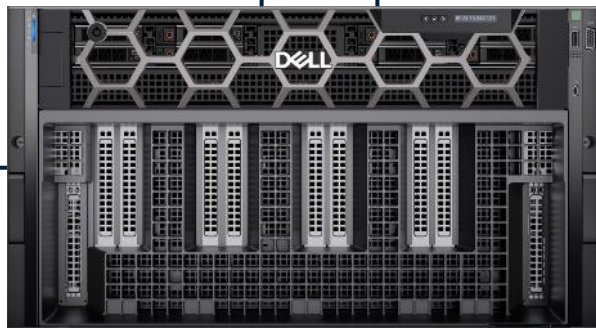
PowerEdge XE9680

2ソケット対応

- 最高TDPで、Intel® Xeon® Sapphire Rapids スケーラブル・プロセッサ2基搭載可能
- 6U空冷式、周囲温度35°Cまで対応
- 1200mmラック対応

高速化、メモリ容量に対応

- 32 x DDR5 DIMM
- 4800 MT/s (1DPC) or 4400 MT/s (2DPC)



AI

Large Model Training

最大16のドライブをサポート

- 最大 8x SAS/SATA/NVMe Gen4 または 16x E3.S
- ブート用ホットプラグBOSS N-1(オプション)
- SW RAID/PERC12をサポート

GPU稼働に最適化

- 8xNVIDIA H100 SXM5 700W 80GB
- 8xNVIDIA A100 SXM4 500W 80GB
- 完全なNVLINK相互接続

I/O

- x16 PCIe Gen5 スロット x 10
- OCP NIC 3.0 x 1
- 2x 1GbE LOM

GPU OPTIMIZED

TARGET WORKLOADS

AI-ML/DLトレーニング

最高性能のGPUにより、AI/MLトレーニングのワークロード、特に大規模モデルのトレーニングで最大限のパフォーマンスを実現

高性能コンピューティング

高性能コンピューティング、ラックあたりのCPUおよびGPUコア密度の向上により、HPCシミュレーションモデリングが可能

対象業種

医療、CSP & CRISP、金融、HPC、連邦政府、研究/大学

イノベーションを加速...

高密度でスマートにアクセラレーション



ワークロード

AI : ML/DL学習
モデリングおよびシミュレーション

ハイパフォーマンスコンピューティング

最適なワークロードと業種 : ヘルスケア、
ライフサイエンス、学術系



XE9640: 2U/2S

インサイトを解き放つ、AI向けに専用設計された
スマート冷却稼働の超高密度サーバー。
従来型コンピューティングのリアルタイムのインサイト入手の限界を突破。

✓ 高密度なアクセラレーション

要求の厳しいML/DL学習及び
モデリング&シミュレーションを
加速する、インテルベースの
2Uラック型4-Way GPUサーバー。

✓ 冷却に関する効率

GPUとCPUに対する
Direct Liquid Coolingが
パフォーマンスと電力効率を
最大化、TCOを削減。

✓ I/Oの柔軟性

4本のPCIe Gen5スロットが
4基のGPUと1対1で通信、
GPU使用率を継続的に
最大化。

PowerEdge XE9640

デュアルソケット

- インテル® Xeon® Sapphire Rapids スケーラブル・プロセッサ2基搭載可能（最高TDPまでサポート）
- CPUとGPUを直接液体冷却方式で冷却
- 1200mmラック対応

高速化、メモリ容量に対応

- 32 x DDR5 DIMM
- 4800 MT/s (1DPC) or 4400 MT/s (2DPC)

I/O

- 最大4つの x16 PCIe Gen5 スロット
- ネットワークカード用 OCP3.0

GPUの柔軟性と最適化

- 4x NVIDIA H100 SXM 700W
- 4x インテル MAX 1550 OAM 600W（コードネーム：Ponte Vecchio）
- GPU間でクアッド接続された NVLinkまたはXeLinkの機能

最大6のドライブをサポート

- SAS SSD、またはNVMe U.2、E3.Sドライブ
- ブート用ホットプラグBOSS N-1（オプション）
- 高性能ソリューション向けにPERC12をサポート

Diverse GPU Offerings

Direct Liquid Cooled



TARGET WORKLOADS

AI-ML/DLトレーニング

最高性能のGPUにより、AI/MLトレーニングのワークロードで最大限のコスト パフォーマンスを実現

高性能コンピューティング

CPUとGPUのコア密度を高め、液体冷却方式にすることで以下を実現

- TCOの削減
- ラックの最大活用
- グリーンデータセンターの実現

対象ワークロードと業種

ワークロード: ML/DLトレーニング & シミュレーションモデリング
業種: 金融、医療、高等教育、連邦政府、小売、CSP & CRISP、スーパーコンピューティング

GPU OPTIMIZED

イノベーションを加速...

専用設計ならではの圧倒的なパフォーマンス



ワークロード

AI : ML/DL学習

ハイパフォーマンスコンピューティング

最適なワークロードと業種 : 石油探掘、ヘルスケア、CSP、金融、HPC、官公庁、学術系

コンピュートとアクセラレーター パフォーマンスの最大化により
要求の高いAI、HPC、データ分析のワークロードとそのパワーユーザーを
けん引。分析結果のインサイトへの転換を自動化。



XE8640: 4U/2S

✓ AIの成果取得を加速

AIの学習性能を高速化する
最大4基のNVIDIA H100と
最高TDP 350WのCPU。

✓ 空冷設計

Dellの次世代マルチベクター
クーリングと独自の冷却
アプローチにより、最高クラスの
温度を4Uラックシャーシで
サポート。

✓ スケールアップの柔軟性

最大4本のPCIe Gen5
スロット、NVIDIA Multi-
Instance GPU (MIG)、
GPU Direct Storageによる、
最速のデータ転送がコアあたり
性能を強化。

PowerEdge XE8640

2 Socket Capable

- インテル® Xeon® Sapphire Rapids スケーラブル・プロセッサ2基搭載可能（最高TDPまでサポート）
- 4U空冷式（LAAC）、最大周囲温度35度
- 奥行1070mmの標準ラックに搭載可

Support for high-speed and memory capacity

- Up to 32 DDR5 DIMMs
- 4800 MT/s (1DPC) or 4400 MT/s (2DPC)

HPC & AI



最大8のドライブをサポート

- SAS SSD、またはNVMe U.2、E3.Sドライブ
- リアアクセス ホットプラグ対応ブート専用デバイス、BOSS N-1(オプション)
- SW RAID/PERC12をサポート

I/O

- Up to 4 x16 PCIe Gen5 slots
- OCP NIC 3.0
- 2 x 1GbE LOM

GPU稼働に最適化

- 4×NVIDIA H100 SXM5 80GB 700W
- 完全なNVLINK相互接続

TARGET WORKLOADS

AI-ML/DLトレーニング

最高性能のGPUにより、AI/MLトレーニングのワークロード、特に大規模モデルの学習で最大限のパフォーマンスを実現

高性能コンピューティング

高性能コンピューティング、ラックあたりのCPUおよびGPUコア密度の向上により、HPCシミュレーションモデリングが可能

対象業種

オイル&ガス、金融、医療、HPC、連邦政府、小売、CSP、研究/大学

GPU OPTIMIZED

Accelerate innovation ...

More capable & agile AI compute



ワークロード

AI : ML/DL学習

HPC、VDI、高性能グラフィックス

デジタルツイン、レンダリングファーム、
仮想化



R760xa: 2U/2S



AIやモデリング&シミュレーションの分析を最大化する、
拡張性に優れたコンピュート。
2Uの高密度筐体で最高クラスの柔軟性を提供。



導入の容易性

従来型ワークロードと
新興ワークロードとの両方を
加速、最新アクセラレーター
搭載の2Uラック空冷サーバー。



柔軟なアクセラレーション

AMD、インテル、NVIDIAの
アクセラレーター搭載に最適化
され、多様なワークロードで
AIの成果を加速。ビジネスの
成長に応じたスケールアウトも
可能。



アウトカムの提供

最大4基の350W GPUまたは
12基のシングルワイドGPUを
サポート。アプリケーション性能を
高速化して最短で演算結果を
取得。

PowerEdge R760xa

2 Socket Capable

- インテル® Xeon® Sapphire Rapids スケーラブル・プロセッサ-2基搭載可能 (最高TDPまでサポート)
- 2U メインストリーム設計、空冷式
- 奥行1070mmの標準ラックに搭載可

高速化、メモリ容量に対応

- 32 x DDR5 DIMM
- 4800 MT/s (1DPC) or 4400 MT/s (2DPC)

Extension of Mainstream PE

Diverse GPU Offerings



I/O

- Up to 4 x 16 PCIe Gen5 slots
- OCP 3.0 for network cards

最大8のドライブをサポート

- SAS SSD、またはNVMe U.2、E3.Sドライブ
- リアアクセス ホットプラグ対応ブート専用デバイス、BOSS N-1(オプション)
- 高性能ソリューション向けにPERC12をサポート

GPU最適化

- 最大4基のDWまたは12基のSW PCIe Gen5 GPUを搭載
NVIDIA、Intel、またはAMDGPUをサポート
- NVLINK、XGMI、XeLink Bridgingのサポートにより、メモリとパフォーマンスのスケールアップが可能になりGPUフォークアアプリケーションを強化
- マルチインスタンスGPU(MIG) でマルチテナンシーに対応

TARGET WORKLOADS

AI-ML/DLトレーニングと推論

柔軟なアクセラレーター構成により、最高のコストパフォーマンスのAI-ML/DLワークロードと推論が可能に

高性能コンピューティング

CPUおよびGPUコア密度の向上により、HPCシミュレーションモデリングが可能

レンダーファームと仮想化

マルチテナンシーによりGPU使用率を高め、密度を落とさずに複数のユーザーに対応

GPU OPTIMIZED

Reimagine IT Possibilities...

R760xd2



ワークロード

ファイルおよびオブジェクトストレージ
ビデオキャプチャと監視

動画ストリーミング

より高性能で迅速な
サーバー ストレージ ソリューション



構成や保守の容易な
オブジェクトストレージ テクノロジーで
増大する非構造化データのニーズに対応

- ✓ **より多くのデータを保存**
3.5インチドライブの
搭載数を7%増加
- ✓ **柔軟性の向上**
3.5インチHDDと
NVMe SSDとの
ネイティブな階層化が
可能
- ✓ **保守を節約**
新しい外付けレール
システムで、保守コス
トを削減

PowerEdge R760xd2

最大28のドライブをサポート

- 24 + 4 3.5インチドライブ
- オプションの、リアアクセス ホットプラグ対応
ブート専用デバイス、BOSS N-1 (2 x M.2 NVMe)

高速化、メモリ容量に対応

- 16 x DDR5 DIMM
- 4800 MT/s



2ソケット対応

- 最大32コアのインテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサ（Sapphire Rapids）を
最大2基搭載可能

柔軟なI/O

- 最大4つのPCIe Gen4スロット
- ネットワークカード用OCP3.0

- 密度を最適化した最新世代の3.5インチストレージドライブをサポート
- ネイティブなインボックス階層化のためのHWオプションを提供する能力
- 業界最高水準の管理性とセキュリティ

TARGET WORKLOADS



オブジェクト

1GBあたりのコストを最適化した大幅拡張
が可能なストレージソリューションに最適



ファイル

コア数、メモリ、ネットワークのバランスにより、
オープンマーケットおよびベンダー最適化ファ
イルストレージをサポート



映像サーベイランスと分析

映像サーベイランス用に十分なストレージを
必要とするデータセンター向けで、インボック
ス解析のオプション付き

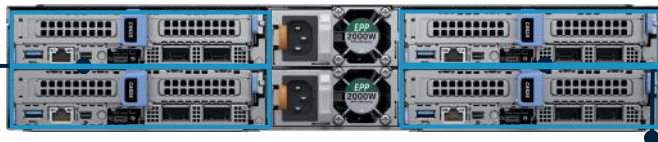
STORAGE OPTIMIZED

モジュラー

PowerEdge C6620

16 x NVMe Gen4 ドライブをサポート

- 4 x NVMe Gen4ドライブ/コンピュータノード



最大4ノード

- プロセッサあたり最大56コアの第4世代インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサを最大2基搭載可能
- メモリ速度最大4800MT/s

柔軟な I/O

- 最大 2つのPCIe Gen5 スロット
- 1 x 16 PCIe Gen5 OCP 3.0、ネットワークカード用
- SNAP I/Oサポート

- 電源機能、サーマル機能を向上させたPowerEdge C6600の新シャーシ
- 直接液体冷却（DLC）対応
- 業界最高水準の管理性能とセキュリティ

TARGET WORKLOADS



ハイパフォーマンス コンピューティング（HPC）

高いコンピュータ性能とラックあたりのコア/ノード密度により、HPC、研究、レンダリング、ベクター化、Advanced Vector Extensions (AVX) 活用に最適



財務分析 / High Frequency Trading

中程度の負荷の従来型データベースと、低・中程度のローカルストレージを使用したスケールアウト型データベース



Hyper-Performance Compute

HPCには、最高のメモリ性能とスケールアウトクラスタのための1DPCシステム設計が必要

MODULAR

C6600のシャーシオプション

C6400 (前世代)



C6600



バックプレーンなしシャーシ

- フロントドライブなし、M.2ブートドライブによる内部ブート方式
- エアフローとサーマル性能の向上
- **HPC、HFT、SaaS/aaS、Hadoop**コンピュートノード、**外部HDFS**ストレージ付き

16x 2.5インチオールNVMeバックプレーンシャーシ

- 高速ストレージを必要とするアプリケーション向けに最適化
- 最大4つのNVMe (Gen4) ドライブ/コンピュートスレッド; 内蔵M.2ブートドライブ
- **vSAN、SDS、HPDA、HCI**

16x 2.5" SAS/SATAバックプレーンシャーシ

- 高性能コンピューティングおよびストレージ向けに最適化
- 最大4つのSAS/SATAドライブ/コンピュートスレッド; 内蔵M.2ブートドライブ
- **HPC、HPDA、SaaS/aaS、ファイナンシャルモデリング、HCI、vSAN**

PowerEdge MX760c

柔軟なI/O

- 3 x 高スループット、低レイテンシー Fab A、B、C



最大8 x EDSFF E3.S NVMe Gen5または 6 x 2.5インチSAS/SATA またはNVMe Gen4

- BOSS-N1 (M.2 NVMe/HW RAID)
- PERC12 - H965i NVMe Raid

2ソケット対応

- 最大56コアの第4世代インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサを最大2基搭載可能

高速化と高密度化するメモリ容量に対応

- 2 x DIMM/チャンネル用に最適化
- 32 x DDR5 DIMM
- 4800 MT/s
- インテル® Optane パーシステント・メモリ 300 シリーズ *QNS

- PowerEdge MX7000モジュール式シャーシ用に設計
- インテル® Built-In AI Accelerationを統合、次世代QAT
- 業界最高水準の管理性とセキュリティ

TARGET WORKLOADS



汎用IT、仮想化、コンテナ化、 ビジネスアプリケーション

スケーラブルプロセッサコア数、より高性能なメモリ構成、十分なストレージ容量とネットワーク構築機能



ソフトウェア定義のストレージと ソフトウェア定義ネットワーク

フレキシブルで豊富なストレージ構成、高速ネットワーク、冗長IO



データベース、ビッグデータ分析

コンピューティングとメモリが豊富な構成
(構造化DBと非構造化DB、インメモリDB、ビッグデータ分析)

MODULAR

CSP向けクラウドサーバー

アーキテクチャを加速

サービスプロバイダー向けの最先端の製品でビジネススピードを促進



CSP向けに
テイラーメイドされた
PowerEdgeソリューション

信頼できるパートナーによる
適切な製品の提供

世界中のお客様のニーズに応える信頼の
パートナーによる製品による製品提供で、
信頼性、生産性、安全性が向上します。



ビジネスバリューを
迅速に創出

スピードとイノベーションで
迅速に市場投入

最先端のテクノロジーと自動化により、
CSPワークロード用にカスタマイズされた
プラットフォームの調整と検証にいち早く
アクセスできます。



大規模環境を
一括管理

導入システムの早期立ち上げに
特化した機能とサービス

大規模かつ異種混在するクラウド
データセンター向けに設計・最適化
されたソリューションで、データセン
ターの管理と保守を容易にします。



Reimagine IT Possibilities...

クラウドサービスプロバイダー向けに設計されたオープンプラットフォーム、クラウドスケールサーバー*

ワークロード

クラウド/仮想化
スケールアウト型データベース

ソフトウェア定義のストレージノード



HS5610 : 1U/2S

1U、コールドアイル構成オプション



HS5620: 2U/2S

より多くのストレージとPCIeスロットによる
柔軟性

大規模かつ異種混在のSaaS、IaaS、PaaSデータセンター向け
最先端テクノロジーを提供

- ✓ **CSPのワークロードの70%をカバーする設計**
幅広い選択肢のインテルのミッドレンジコア数のCPU、適切なメモリ容量、前面I/Oでコールドアイルからの保守が可能な構成
- ✓ **オープンエコシステムで選択肢を拡大**
マルチベンダーのシステムの一括管理に最適な「Open Server Manager」は、OpenBMC™から作られたオープンソースの管理オプション
- ✓ **CSPのニーズに合わせたイラーメード製品**
容易に拡張できる構成により、選定されたコンポーネントと検証済みワークロードでクラウドサービスプロバイダーをサポートし、サポートに関する余分なコストやオーバーヘッドを最小限に抑制

*Hyperscale Nextプログラム対象のお客様限定の個別販売製品です

DELL Technologies

PowerEdge HS5620 Key Features

クラウドサービスプロバイダー向けに最適化

- 最大2基の次世代Xeonスケーラブル・プロセッサ、コードネームSapphire Rapids (シングルプロセッサ構成も選択可能)
- 最大16 x DDR5 RDIMM (最大2TB)
- 最大4800MT/s

システム管理

- iDRAC または **OpenBM NEW**



柔軟なストレージ

- 8x 2.5インチ NVMeまたはSAS4/SATA
- 8x 3.5インチ SAS3/SATA
- 12x 3.5インチ SAS3/SATA + 2x 2.5インチ SAS3/SATAまたはNVMe(オプション)
- 16x 2.5インチ SAS3/SAS4、SATA + 8x 2.5インチ NVMe(オプション)
- SW RAID、BOSS-N1、PERC11 / PERC12

I/O

- 最大7つのI/Oスロット:
 - 4x PCIe Gen4 スロット
 - 2x PCIe Gen5 スロット
 - 1x OCP 3.0 (ネットワークカード用)
- **チャンネルファームウェア デバイス (NIC & NVMe)**

- インテルの禁輸に基づくMCC TTM
- 初期のエンジニアリングサンプルとpost-RTSの取り組みによるサポート
- CETエンジニアリングラボのリソース
- CSP サービスとラック統合

TARGET WORKLOADS



仮想化 / クラウド

低・中程度のローカルストレージを必要とする中密度の仮想化およびクラウドネイティブ



スケールアウト型データベース

中程度の負荷の従来型データベースと、低・中程度のローカルストレージを使用したスケールアウト型データベース



ソフトウェア定義のストレージノード

ソフトウェア定義ストレージの導入用に最大4つの大容量ドライブ (メディア/Hadoop/グリッド)

*Gen5 PCIe: upsell

DELL Technologies

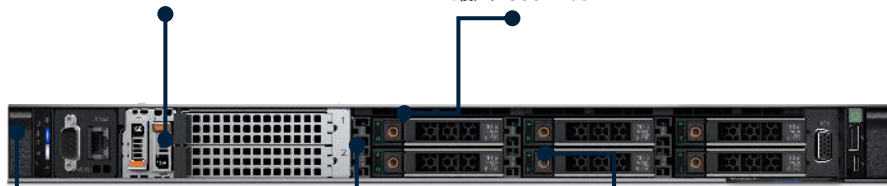
PowerEdge HS5610 Key Features

コールドアイル対応 **NEW**

- コールドアイルから容易に保守可能なため、効率的なDC管理が可能 (2x OCP + 6x 2.5インチ)

クラウドサービスプロバイダー向けに最適化

- 最大2基の次世代Xeonスケーラブル・プロセッサー、コードネームSapphire Rapids (シングルプロセッサー構成も選択可能)
- 最大16 x DDR5 RDIMM (最大2TB)
- 最大4800MT/s



柔軟なストレージ

- 4x 3.5インチ SAS3/SATA
- 10x 2.5インチ SAS3/SAS4、SATA、またはNVMe
- 8x 2.5インチ SAS3/SATAまたはNVMe
- 6x 2.5インチ NVMe
- オプションの2x 2.5インチ リアSAS3/SATAまたはNVMe
- SW RAID、BOSS-N1、PERC11 / PERC12

I/O

- 最大3つのI/Oスロット:
 - 2x PCIe Gen4 / Gen5 スロット*
 - 1x OCP 3.0 (ネットワークカード用)
- チャンネルファームウェアデバイス (NIC & NVMe SSD)

システム管理

- iDRAC または OpenBM **NEW**

- インテルの禁輸に基づくMCC TTM
- 初期のエンジニアリングサンプルとpost-RTSの取り組みによるサポート
- CETエンジニアングラボのリソース
- CSP サービスとラック統合

TARGET WORKLOADS



仮想化 / クラウド

低・中程度のローカルストレージを必要とする中密度の仮想化およびクラウドネイティブ



スケールアウト型データベース

中程度の負荷の従来型データベースと、低・中程度のローカルストレージを使用したスケールアウト型データベース



ソフトウェア定義のストレージノード

ソフトウェア定義ストレージの導入用に最大4つの大容量ドライブ (メディア/Hadoop/グリッド)

*Gen5 PCIe: upsell

DELLTechnologies